**深圳佰维存储科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录汇总表**

**（2024年1月18日）**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 🗹特定对象调研 🞎分析师会议  🞎媒体采访 🞎业绩说明会  🞎新闻发布会 🞎路演活动  🞎专场机构交流会 🗹现场参观  🞎其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 平安证券 蒋朝庆、东方阿尔法 梁少文、前海旭鑫资产 李凌飞、财通基金 张胤、鑫鼎基金 刘磊、深汇城控股 魏文涛、安信证券 杨中国、泽源资产 杨延顺、中电科投资 李畅、怀远投资 李岩岩、浙商资管 杨超、运舟资本 肖燕松、中泰证券 杨旭、华金证券 王臣复、招商证券 谌薇、中银证券 李圣宣、山西证券 田发祥、个人投资者 陈文生 |
| **会议时间** | 2024年1月18日 13：30-15：30 |
| **会议地点** | 佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司管理层  董办工作人员 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1月18日的调研主要分为参观佰维存储惠州封测制造中心和投资者互动交流问答环节。   1. **参观情况**   本次调研，投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。  **二、交流环节：**  **Q1. 请问公司近期在研发上有什么新进展？**  A1：公司高度重视技术研发创新，近期成功研发并发布了支持CXL2.0规范的CXL DRAM内存扩展模块，兼具支持内存容量和带宽扩展、内存池化共享、高带宽、低延迟、高可靠性等特点，赋能AI高性能计算。此外，在IC芯片方面，公司第一颗主控芯片研发进展顺利，已经回片点亮，正在进行量产准备。  **Q2. 公司定增的进度如何？**  A2：公司定增正在稳步推进中，相关事项敬请留意公司公告。  **Q3.** **除Meta外，公司在智能穿戴产品上还有哪些大客户合作？**  A3：公司是Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta的存储器芯片供应商，除此之外，公司智能穿戴存储产品还进入了Google、小天才等知名品牌的智能穿戴设备供应体系。  **Q4.** **请问公司近期的业绩情况如何？**  A4：目前公司经营情况已逐步转好，预期2024年行业将迎来景气复苏，公司业绩将显著改善。公司积极把握新一代信息技术发展趋势，增强硬科技实力，努力为存储产业链贡献价值。  **Q5. 公司先进封测是否有涉及HBM相关技术？**  A5：公司拟定增募资建设的晶圆级先进封测项目可以构建HBM实现的封装技术基础，公司将通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级封测能力，具备存储器和逻辑IC封测能力，有利于公司把握大湾区半导体产业链发展机遇，并探索存储IC与计算IC的整合封装能力。  **Q6. 公司的全球化布局是怎样的？**  A6：公司坚持贯彻全球化战略布局，持续发力海外市场，海外业务发展迅猛。公司在北美、拉美、印度、欧洲、中国台湾地区等地发展并打造了强有力的本地化服务、生产交付和市场营销团队。未来，公司将借助全球化运营/交付服务网络，进一步开拓国际一流客户和各地区性市场，加强品牌形象建设，提升全球市场占有率。  **Q7. 当前公司的库存情况怎么样？**  A7：整体来看，公司当前的库存情况比较健康，具体可关注公司后续披露的年报。  **Q8. 公司目前已掌握哪些先进封装技术？**  A8：公司掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，为NAND Flash芯片、DRAM芯片和SiP封装芯片的大规模量产提供支持。  **Q9. 公司产品主要应用领域有哪些？**  A9：公司存储器产品应用领域覆盖智能手机、平板电脑、智能穿戴、机顶盒、智能汽车、工控应用、PC、工业互联网等主流应用场景。 |
|  |  |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2024年1月18日 |
| **备注** | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。 |